## 适配板材

★ PPO/PPE

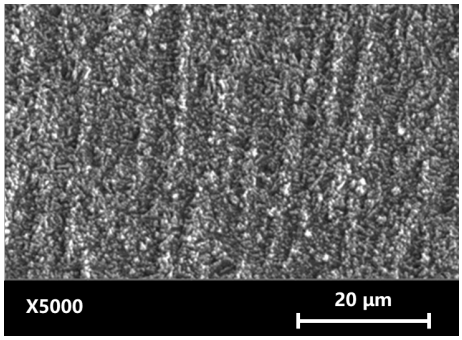
R-HS5

## 典型应用

★ Server 服务器

★ HDI 高密度互联

★ HSD 高速数字电路 (Ultra low loss)




## 技术指标

| 项目 | | 单位 | 规格参数 | | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标称厚度 | | μm | 18 | 35 | IPC-4562A |
| 单位面积质量 | | g/m² | 151 | 285 | IPC-TM-650 2.2.12 |
| 抗拉强度 | 常温 | MPa | 300 | 300 | IPC-TM-650 2.4.18 |
| | 180℃ | | 150 | 150 | |
| 延伸率 | 常温 | % | 15 | 15 | |
| | 180℃ | | 6.0 | 6.0 | |
| 粗糙度 Rz | 压合面 | μm | 1.7 | 1.7 | IPC-TM-650 2.2.17 |
| | 阻剂面 | | 3.0 | 4.0 | |
| 剥离强度 | PPO | lb/inch | 3.0 | 3.0 | IPC-TM-650 2.4.8 |

★ 以上数据为典型值，非保证值。

★ 半固化片会影响剥离强度，铜箔使用前请进行半固化片匹配实验或咨询德福科技技术服务人员。